

## PRESSEMITTEILUNG

### **ASAP Gruppe auf 12. Internationalem Fachkongress „Bordnetze im Automobil“ in Ludwigsburg**

ASAP Expert:innen gaben Einblicke in ihr umfangreiches Leistungsportfolio/ Sehr hohe Durchgängigkeit bei allen Prozessschritten als Erfolgsfaktor von ASAP/ Wachsender Energiebedarf, komplexere Technik und zunehmende Automatisierung von Automobilen sorgen für neue Anforderungen bei der Bordnetzentwicklung und -produktion

**Ingolstadt, 13.05.2024. Beim wichtigen Treffpunkt der Automobil-Bordnetz-Branche, dem 12. Internationalen Fachkongress „Bordnetze im Automobil“ in Ludwigsburg, diskutierten vom 7. bis 8. Mai 2024 ASAP Experten und Expertinnen gemeinsam mit rund 400 weiteren Fachkundigen neue Trends und Herausforderungen bei der Entwicklung und Implementierung der elektrischen und elektronischen Bestandteile in Automobilen. Die ASAP Gruppe, Top-Engineering-Partner der Automobilindustrie, stellte im Forum am Schlosspark in Ludwigsburg zugleich ihre weitreichenden Leistungen bei der Bordnetzentwicklung vor. Diese zeichnen sich durch eine besonders hohe Durchgängigkeit entlang des gesamten Prozesses von der Architektur und Konzeptdefinition über die Elektrologik und die Erstellung des Schaltplans bis zum Verbau aus.**

„Angesichts der zunehmenden Elektrifizierung von Fahrzeugen zeigt sich einmal mehr der Mehrwert unseres Bordnetz-Portfolios. Dadurch, dass wir bei ASAP sämtliche Leistungen entlang des gesamten Prozesses aus einer Hand bieten, überzeugen wir auch trotz der sich stark veränderten Rahmenbedingungen durch effiziente Lösungen. Ich freue mich, dass wir unseren Ansatz auf dem diesjährigen Bordnetz-Kongress einmal mehr vorstellen und uns zudem intensiv zu diversen Fragen der Bordnetzentwicklung austauschen konnten“, bilanziert Robert Werner, COO bei der ASAP Gruppe.

So ging es im baden-württembergischen Ludwigsburg unter anderem auch darum, wie die zunehmende Digitalisierung und Automatisierung für zukünftige Fahrzeuggenerationen erfolgreich abgebildet werden kann und welche Rolle virtuelle Tools dabei spielen. Ebenfalls im Fokus: Aspekte der Nachhaltigkeit und der Sicherheit sowie die Sicht der OEMs auf die Herausforderungen bei der Bordnetzentwicklung und -produktion.

„Deutlich wurde einmal mehr, dass die Bordnetzentwicklung ein Schlüsselbereich ist. Sie bildet den Wandel in der Automobilindustrie konkret in unzähligen Herangehensweisen, Prozessen und Komponenten ab und muss dabei stets zukünftige Anforderungen wie eine zunehmende Anzahl von Fahrzeugfunktionen und neue Antriebe antizipieren“, sagt Stefan Schmidt, Director Division Wiring Systems bei ASAP.

### **Über den 12. Internationalen Fachkongress „Bordnetze im Automobil“ in Ludwigsburg**

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist der internationale Kongress „Bordnetze im Automobil“ in Ludwigsburg (Baden-Württemberg) eine feste Größe für Experten und Expertinnen aus den Bereichen Bordnetzentwicklung und Bordnetzproduktion. Fachliche und strategische Themen stehen dabei ebenso im Mittelpunkt wie das Knüpfen neuer Branchenkontakte.

#### **Bildmaterial:**



Die ASAP Expert:innen stellten die Leistungen der ASAP Division Wiring Systems vor.

#### **Ihre Ansprechpartnerin:**

ASAP Holding GmbH, Kerstin Hebler, Tel: Tel: +49 (0) 152 0181 0446, E-Mail: [kerstin.hebler@asap.de](mailto:kerstin.hebler@asap.de)

### **Die ASAP Gruppe**

Mit einer klaren Fokussierung auf die Zukunftstechnologien des Automobils wurde die ASAP Gruppe am 01. Januar 2010 gegründet. Heute blickt der Entwicklungspartner der Automobilindustrie auf ein nahezu einzigartiges Wachstum im Automotive Engineering zurück: Stand Januar 2024 waren 1.700 Mitarbeitende an neun Standorten für die Unternehmensgruppe tätig. Die ASAP Gruppe, Tochtergesellschaft der HCLTech, bietet umfassende Entwicklungsleistungen mit Fokus auf Megatrends wie E-Mobilität, Autonomes Fahren und Connectivity. Den strategischen Entwicklungsschwerpunkt legt ASAP mit seinen fünf Leistungssegmenten – Elektrik/Elektronik, Software, Consulting & Service, Erprobung und Fahrzeugentwicklung – auf die zukunftsorientierten Technologiefelder.